



次世代配線板研究会 2024年度第1回公開研究会

主催：次世代配線板研究会

◆公開研究会のご案内

研究会テーマ「【最終報告会】Landless Via(ランドレスビア)の有効性と可能性」

次世代配線板研究会の最終報告会を行います。次世代配線板研究会で長年研究を進めて来た次世代配線板の姿、Landless Viaの有効性と可能性について、研究会が辿り着いた最終の姿をご報告致します。また、大きな課題の一つである位置精度を確保する上で最も重要な工程である露光にフォーカスして公開研究会を開催致します。

開催日時 2025年1月29日(水) 13:00~17:00

開催方式 WEB研究会(Zoom Webinarシステム利用)

※参加URL等の聴講情報は、申込受付時のメールにてご連絡致します。

13:00~13:05

オープニング

開会挨拶 次世代配線板研究会 主査 高木 清

13:00~14:00

① 「ランドレスプリント配線板の優位性と量産化への提案」

旧次世代配線板研究会(元パナソニック) 浦西泰弘 氏

<概要>

電子機器の小型化、高機能化および高性能化に対応し、高密度実装を可能にする、ランドレスプリント配線板の優位性と量産化に向けた信頼性の考察と現有の主要設備による、穴加工およびレジスト露光のずれを考慮した、量産化設計の施策と提案を報告する。

14:00~15:00

② 「ランドレスビア特性の論理的考察」

次世代配線板研究会(KEI Systems) 前田 真一 氏

<概要>

ランドレスビアの電気的特性についてこれまで3Dフィールドソルバーの解析結果に基づき評価してきた。今回、製造誤差による微妙な電気的特性変化の評価について、3Dフィールドソルバーでもビアの製造誤差による特性の微妙な違いでの解析精度に非常に高い周波数の材料特性やパラメーターの設定、アルゴリズムなど問題から、定量的なデータ発表はミスリードを導きかねない。そこで今回は、ビアの特性に対する論理的考察を行い定性的な考察を行う。

(休憩:適時進行状況による)

15:00~16:00

③ 「次世代製造プロセスに対応する投影露光装置の現状と課題」

ウシオ電機株式会社 高橋遼太郎 氏

<概要>

近年、半導体の高機能及び高性能化が進み、高度なパッケージング技術が数多く提案・開発されている。半導体の受け皿となる基板においても微細化や狭ピッチ化が求められ、多様な製造プロセスの適用が検討されている。本発表では投影露光装置の現状とプロセス検証で得た課題について紹介する。

16:00~17:00

④ 「直描式露光装置(DI)現状と課題」

(株)アドテックエンジニアリング 渡辺 健二 氏

<概要>

直描式露光装置の取り巻く状況とファイン領域向け最新装置の現状及び、露光の動作原理とアライメント方法について解説を行い、目指すべき方向性と課題について紹介する。

17:00~17:05 閉会挨拶

次世代配線板研究会

※プログラムは変更になることがありますので、ご了承ください。

参加要項

定員 150名(先着申込順 定員になり次第締め切ります)

参加費(消費税込み)

正会員:5,000円、学生会員:1,000円、研究会会員:別払い、シニア会員:2,000円

名誉会員:無料、賛助会員の社員:5,000円、賛助会員(クーポン利用):無料

非会員一般:10,000円、非会員学生:2,000円、協賛団体会員:5,000円

注意事項(参加方法)

①申込が受理されますと、**返信メールで公開研究会への参加 URLやお支払いに関する情報**をご連絡致します。

②ご申請の手順に従って、参加費のお支払いをお願い致します。

(お支払い方法:クレジットカード決済またはコンビニ決済のみ)(手数料学会負担)

③領収書(宛名会社名選択可)のご発行は、返信メールのマイページから**決済後に即日出力が可能**です。

④WEBの領収書が原紙扱いになりますので、ご了承ください。

⑤賛助・特別クーポンは、1枚/1口まで(複数口の場合は口数分)利用可能です。申込時にクーポン番号等の全項目を記入しないと、利用できません。※複数枚使用希望がある場合はお問い合わせください。

*キャンセルポリシー

お申込み後のキャンセルはできません。

下記から参加申し込みをお願いします。

会員

賛助会員

協賛会員

非会員

※クーポン使用の場合は「クーポン利用」をご選択ください。

問い合わせ先 一般社団法人エレクトロニクス実装学会

E-mail: info¥jiep.or.jp(メールアドレスは¥を@に置き換えてください)